

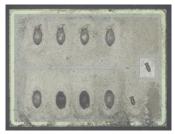
NEW RELEASE LTEC Corporation Your most experienced partner in IP protection

Your most experienced partner in

SiC MOSFET(1200V): LGE LGE3M181200 概要解析レポー F



パッケージ



SiC MOSFETチップ

レポート概要

中国は2024年のSiCパワー半導体の販売額で、上位10社中3社を占めるほどにシェアを伸ば しています。今後もEV(電気自動車)や再生可能エネルギー分野他、様々な分野への採用が 拡大していくと予測されます。

中国のSiCパワー半導体への参入企業は増加しており(推定100社程度)、エルテックでは、 BYD、Basic、三安やInventchipといった主要メーカーのSiC技術レベルの確認を行っており ますが、主要メーカー以外の調査も中国のレベルを確認する上で重要と捉えています。

今回、中国LGE (Luguang Electronic Technology)社のSiC MOSFETについて、その技術 レベルを確認した概要解析レポートをリリースしました。

製品特徴

型番: LGE3M18120Q V_{DS} =1200V、 I_{D} =105A、 $R_{DS(ON)}$ =18m Ω 製品リリース日:2024年(データシート)

データシート: LGE3M18120Q データーシート

アプリケーション

モータードライバー、太陽光/風力インバータ、EV充電ステーション、 AC/DC、DC/DCコンバータ、無停電電源装置(UPS)など

解析内容&レポート価格

概要解析レポート 価格 ¥300,000 (税別) 発注後1weekで納品

- ・断面解析により、セル部、チップ端部とEpi層構造の確認を行っています。
- ・主要メーカー(Basic、Wolfspeed等)と面積当たりのオン抵抗やセルピッチなど 技術レベルの比較を行っています。

本製品の詳細な構造解析レポート (予定価格 ¥600,000)のご要望がございましたら、 エルテックまでお問い合わせください。

概要解析レポート 目次

【目次】		Page
1 デバイスサマリー		•
Table1-1:デバイスサマリー・・・		3
1-1. 解析結果まとめ		
Table1-2: デバイス構造:SiC MOSFET		4-5
Table1-3: デバイス構造:レイヤー材料・膜厚		4-3
2-1. 外観観察 · · · ·	• •	7
3 SiC MOSFETチップ概要解析		
3-1. 平面概要解析(OM) (チップ観察) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• •	9
3-2. セル部 断面概要解析 (Epi膜厚・セルピッチ確認) ・・	• •	11
3-3. 外周部 断面概要解析 (耐圧構造確認) · ·	• •	17
4 他社メーカーとの比較・・・	• •	19-20

LGE (Luguang Electronic Technology)

LGEは2002年9月に設立され、ディスクリート半導体の設計、製造、販売を行う企業です。 20年以上のエンジニアリングと製造の経験を持つLGEの製品は、 自動車、スマートホーム、 白物家電、照明、通信、IT、インテリジェント機器など、日常生活や産業用途の電子機器 に幅広く使用されています。

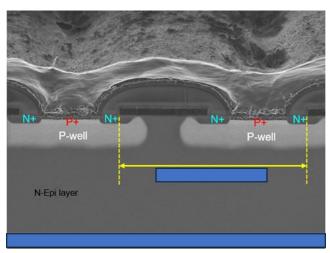
LGE はヨーロッパ、東ヨーロッパ、北米、南米、東南アジア諸国に支店と正規販売代理店 を設立しています。

https://www.lgesemi.com/

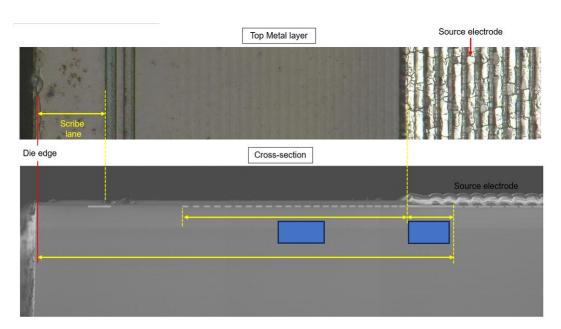
概要解析レポートからの抜粋



チップ全体像(Top metal layer)



セル部 断面SEM像



チップ端部 断面SEM像